

中华人民共和国信息产业部

信运简【2005】28号

关于召开 2005 中国电子信息产品市场高峰论坛暨 第三届中国电子制造服务产业高峰论坛的通知

有关单位：

为了提高中国电子信息企业国际化过程中的跨国协作和价值链协作能力，加强品牌厂商（OEM）与外包提供商们（EMS、ODM等）的跨国合作，推进全球电子制造资源的有效利用，促进国内外电子信息企业的交流和协同，我司定于2005年11月21日—22日在上海举办“2005中国电子信息产品市场高峰论坛暨第三届中国电子制造服务产业高峰论坛”。

论坛将邀请业内国内外知名品牌厂商、制造服务商、电子元器件、设备供应商及分销商、有关行业协会组织等单位 and 行业专家到场，就国际电子制造趋势、制造外包、OEM和EMS之间的选择与管理等论题进行研讨，届时请你单位主管领导和战略管理负责人1-2名出席会议。参会人员回执表请尽快回复。

现将会议有关事项通知如下：

一、研讨内容：

- （一）中国电子信息产品市场发展趋势
- （二）2006全球电子制造展望
- （三）EMS供应商的选择与管理
- （四）增强与OEM伙伴的关系
- （五）如何在EMS供应商和OEM公司之间架起更好的桥梁
- （六）PLM助力全球性的设计和制造外包
- （七）中国OEM如何选择当地EMS来拓展海外市场

二、培训内容:

优化合约制造伙伴关系—成功的关键

三、论坛日期和地点:

论坛地点: 上海国际会议中心

报到时间: 11月20日

培训时间: 11月21日

论坛时间: 11月22日

四、论文组织:

论坛组委会向业界广泛征集“2005 中国电子信息市场高峰论坛暨第三届中国电子制造服务产业高峰论坛”论文,经组委会认真遴选后编辑论文集。

五、其他事项:

论坛会务委托中国电子器材总公司承办。凡参加论坛的同志请填好回执,于2005年11月15日前邮寄或传真至论坛组委会(拟发表演讲需提前联系):

联系人:信息产业部经运司市场处:雷文,电话:010-68208027;
中国电子器材总公司:董方亮、顾津京,电话:010-68207732/33/34
转61/27,传真:010-68132578、68189519

e-mail: dongfl@ceac.com.cn, pd@ceac.com.cn

二〇〇五年十一月四日

